



平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年11月7日

上場会社名 住友ベークライト株式会社
 コード番号 4203 URL <http://www.sumibe.co.jp>

上場取引所 東大

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 林 茂
 問合せ先責任者 (役職名) 経理企画本部副本部長 (氏名) 寺島 郁朗
 四半期報告書提出予定日 平成23年11月10日 配当支払開始予定日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け)

TEL 03-5462-3452
 平成23年12月2日

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第2四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第2四半期	95,326	△2.6	4,266	△31.6	5,193	△25.9	3,614	△1.5
23年3月期第2四半期	97,908	24.1	6,233	—	7,006	—	3,670	—

(注) 包括利益 24年3月期第2四半期 3,305百万円 (—%) 23年3月期第2四半期 △1,277百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第2四半期	15.00	—
23年3月期第2四半期	15.23	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第2四半期	202,637	123,520	60.4
23年3月期	205,090	122,025	59.0

(参考) 自己資本 24年3月期第2四半期 122,355百万円 23年3月期 120,933百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	7.50	—	7.50	15.00
24年3月期	—	7.50	—	—	—
24年3月期(予想)	—	—	—	7.50	15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	190,000	△0.5	8,500	△24.0	10,000	△20.0	4,800	△6.9	19.92

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期2Q	262,952,394 株	23年3月期	262,952,394 株
② 期末自己株式数	24年3月期2Q	22,029,568 株	23年3月期	22,024,150 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期2Q	240,925,754 株	23年3月期2Q	240,948,031 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】4ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	4
2. サマリー情報(その他)に関する事項	4
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	4
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	4
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(四半期連結損益計算書)	
(第2四半期連結累計期間)	7
(四半期連結包括利益計算書)	
(第2四半期連結累計期間)	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	9
(4) 継続企業的前提に関する注記	10
(5) セグメント情報等	10
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	11
(7) 重要な後発事象	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間の世界経済は、欧州では財政危機を背景に金融不安が高まり、米国では高い失業率が続き停滞感が強まり、これまで牽引役であった中国などの新興国においても金融引き締めから成長のスピードが緩むなど、景気は減速傾向を強めてきました。

日本経済は、東日本大震災により甚大な被害を受けましたが、サプライチェーンの建て直しが進み、緩やかに回復してきました。しかし、海外の景気減速に加え円が高止まりするなど先行き不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻く経営環境は、半導体においてはスマートフォンやタブレット端末の情報端末は好調でしたが、薄型テレビやパソコンなどの需要が低迷し、全体としては低調でした。自動車につきましては、国内の生産は震災の影響で大きく減少しましたが、後半から回復が進みました。一方、欧米や中国では販売促進政策の打ち切りなどにより販売の減速が顕著となり、先行きに陰りが見えてきました。また、国内の住宅着工件数は、震災直後の減少から持ち直しの兆しがでてきましたが、復興による本格的な回復にはいたりませんでした。

当社グループは、このような経営環境の中、身の丈経営によりスリム化した企業体質を維持しながら、次の方針を掲げて新たな成長に向けて会社総合力を結集して取り組んできました。

- ①既存製品の拡販、用途拡大
- ②成長市場・分野での事業拡大
- ③新製品の早期戦力化、ソリューションの創出・提供

この結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は前年下半期と比較しますと高機能プラスチック製品や半導体関連材料の販売が伸長し増加しましたが、前年同期比では、円高により在外子会社の売上高が為替換算で大きく減少したことで、連結売上高は953億26百万円（前年同期比2.6%減）となりました。利益につきましても、固定費の抑制や赤字事業の構造改革に注力してきましたが、円高の進行や原料価格の上昇などの悪化要因が大きく、連結営業利益は42億66百万円（前年同期比31.6%減）、連結経常利益は51億93百万円（同25.9%減）となりました。連結純利益は特別損失が前年同期に比べ減少したため、前年同期比微減の36億14百万円（同1.5%減）となりました。

セグメント別販売状況(対前年同期比較)

①半導体関連材料

半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、感光性ウェハーコート用液状樹脂、半導体実装用キャリアテープは、携帯情報端末などの新分野が好調でしたが、薄型テレビやパソコンなどの既存分野で低迷したことや、円高の影響により売上高は減少しました。

半導体基板材料「LαZ®」は、スマートフォンやタブレット端末での採用が拡大し、売上高は順調に伸長しました。

なお、半導体基板材料「LαZ®」は、今後の大幅な需要拡大に対応すべく静岡に加えて宇都宮に第二の生産拠点を設置することを決定しました。

また、6月末に研究体制を再編し、宇都宮を先端材料研究開発・新分野の開拓に特化させ、既存製品の応用研究を顧客に近い拠点で行うべく、既に設置済のシンガポール、中国蘇州に加え、九州と台湾にも研究所を設置することを決定しました。

②回路製品

エポキシ樹脂銅張積層板およびフェノール樹脂銅張積層板は、薄型テレビなどの民生機器向けが伸びず、売上高は減少しました。また、フレキシブル・プリント回路は、一部の不採算分野からの撤退などにより、売上高は減少しました。なお、合理化施策を実施し当初計画どおり赤字の縮小が出来ました。

③高機能プラスチック

フェノール樹脂成形材料、工業用フェノール樹脂および成形品は、国内では自動車分野は震災による影響を大きく受けつつも後半に回復が進み、産業資材分野の鉄鋼関連・住宅設備関連は好調に推移し、欧州や北米では自動車分野を中心に伸長したことで、売上高は全体として増加しました。

なお、工業用フェノール樹脂の生産販売会社として中国江蘇省南通市に設立した「南通住友電木有限公司」に、中国市場の需要拡大への対応を図るべくフェノール樹脂成形材料工場も追加新設することを決定し、来年1月の稼働に向けて準備を進めております。

④クオリティオブライフ関連製品

医療機器製品は、震災の影響による前期末の駆け込み需要の反動がありましたが、胃瘻用ボタンおよび胃瘻造設キットの伸長と、腹腔用低圧持続ドレナージシステム「クリオドレーンバック®」などの新製品の寄与により、売上高は増加しました。

ビニル樹脂シートおよび複合シートは、工業用途が在庫調整などにより伸び悩みましたが、医薬品包装用途が好調なことから売上高は増加しました。

ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板、メラミン樹脂化粧板・不燃板などのプレート・デコラ事業は、震災の影響が大きく、売上高は減少しました。なお、業界初となる不燃の薄物メラミン化粧板「薄物デコラ『イノベア』」を開発し、この事業の柱とすべく8月にプロジェクトチームを結成し拡販活動を開始しました。

防水関連事業は、住宅リフォーム関連は好調で、ビルや工場などの一般建築物関連も堅調だったものの、主力の新築住宅関連が震災などの影響により振るわず、売上高は横ばいで推移しました。

なお、防水関連事業は、7月より当社内の製造部門を住ベシート防水㈱に移管し、製造から販売・工事施工までを一貫して同社で行うことで、顧客対応を強化し一層の事業拡大を図っております。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(2.1) 資産、負債および純資産の状況

①資産の部

総資産は、前連結会計年度末に比べ24億53百万円減少し、2,026億37百万円となりました。

これは主に、たな卸資産が31億21百万円、受取手形及び売掛金が24億67百万円、有形固定資産が12億71百万円増加した一方で、コマーシャル・ペーパーの減額や配当金の支払などにより現金及び預金が101億32百万円減少したことによるものであります。

②負債の部

負債合計は、前連結会計年度末に比べ39億47百万円減少し、791億17百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金が18億55百万円増加した一方で、コマーシャル・ペーパーを50億円減額したことによるものであります。

③純資産の部

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ14億95百万円増加し、1,235億20百万円となりました。

これは主に、配当金の支払18億6百万円およびその他有価証券評価差額金が7億99百万円減少した一方で、四半期純利益を36億14百万円計上したことによるものであります。

(2.2) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末の現金および現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ104億69百万円減少し、273億65百万円となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は37億63百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益、減価償却費の計上および仕入債務の増加による収入と、売上債権およびたな卸資産の増加、退職給付引当金の減少および法人税等の支払による支出の結果であります。前年同期と比べると36億99百万円の収入の減少となりました。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動に用いた資金は71億2百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得および投資有価証券の取得による支出の結果であります。前年同期と比べると22億35百万円の支出の増加となりました。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動に用いた資金は72億34百万円となりました。これは主に、コマーシャル・ペーパーの減額および配当金の支払による支出の結果であります。前年同期と比べると24億89百万円の支出の増加となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

当社グループを取り巻く事業環境につきましては、海外では欧米の財政・金融不安を背景に減速リスクを抱え予断を許さない状況が続く、国内でも輸出の足踏みと円高の長期化による環境悪化が予想され、以前にもまして不透明な状況が続くものと見込まれます。当社の業績に大きく影響する半導体市況については弱含み、自動車市況については大きな回復は見込めない状況が続くものと想定いたします。

このような状況のなかで、当社グループは顧客ニーズを先取りして需要を掘り起こし、全グループ員が一体となり拡販を図ると共に、原料価格の上昇を販売価格に適正に反映することや、身の丈経営の徹底を進めコスト削減を図ることで、業績の維持・向上に努めてまいります。

平成24年3月期の業績見通しにつきましては、平成23年5月10日に公表しました連結売上高2,000億円、連結営業利益135億円、連結経常利益143億円、連結当期純利益80億円から、連結売上高1,900億円、連結営業利益85億円、連結経常利益100億円、連結当期純利益48億円に変更いたします。

なお、本業績予想値の前提となる第3四半期以降の為替レートは、1米ドル75円です。

当期の配当について

平成24年3月期の第2四半期末配当は1株当たり7.5円とすることを決定しました。

また、平成24年3月期の期末配当につきましては、引き続き厳しい経営環境が予想されますが、前述の業績予想を前提に7.5円、年間15円とすることを予定しております。

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	38,774	28,642
受取手形及び売掛金	40,560	43,027
商品及び製品	8,709	9,424
半製品	2,573	2,931
仕掛品	582	825
原材料及び貯蔵品	9,128	10,933
その他	6,342	6,486
貸倒引当金	△179	△104
流動資産合計	106,492	102,165
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	30,245	29,898
機械装置及び運搬具（純額）	24,172	25,151
その他（純額）	18,773	19,413
有形固定資産合計	73,191	74,462
無形固定資産		
のれん	5,255	5,153
その他	1,131	1,086
無形固定資産合計	6,387	6,239
投資その他の資産	19,019	19,769
固定資産合計	98,597	100,472
資産合計	205,090	202,637

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成23年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	28,681	30,536
短期借入金	5,157	5,224
コマーシャル・ペーパー	11,000	6,000
未払法人税等	1,199	1,377
賞与引当金	2,670	2,659
災害損失引当金	1,034	841
その他	10,832	11,623
流動負債合計	60,574	58,262
固定負債		
長期借入金	11,501	11,050
退職給付引当金	6,702	5,551
事業再建費用引当金	363	400
その他の引当金	370	359
負ののれん	790	380
その他	2,761	3,113
固定負債合計	22,490	20,854
負債合計	83,064	79,117
純資産の部		
株主資本		
資本金	37,143	37,143
資本剰余金	35,358	35,358
利益剰余金	79,140	80,947
自己株式	△11,925	△11,928
株主資本合計	139,716	141,520
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,287	488
為替換算調整勘定	△18,570	△18,381
在外子会社の退職給付債務調整額	△1,499	△1,272
その他の包括利益累計額合計	△18,782	△19,165
少数株主持分	1,092	1,165
純資産合計	122,025	123,520
負債純資産合計	205,090	202,637

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
売上高	97,908	95,326
売上原価	69,827	68,920
売上総利益	28,080	26,406
販売費及び一般管理費	21,847	22,140
営業利益	6,233	4,266
営業外収益		
受取利息	48	73
受取配当金	302	324
負ののれん償却額	410	410
持分法による投資利益	89	37
為替差益	165	252
雑収入	169	176
営業外収益合計	1,186	1,274
営業外費用		
支払利息	171	159
雑損失	242	187
営業外費用合計	414	347
経常利益	7,006	5,193
特別利益		
固定資産売却益	221	16
退職給付引当金戻入額	—	402
その他	4	—
特別利益合計	225	419
特別損失		
固定資産除売却損	355	168
投資有価証券評価損	206	9
事業再建関連費用	331	71
減損損失	419	122
解決金等	236	579
環境対策引当金繰入額	73	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	79	—
その他	30	35
特別損失合計	1,732	988
税金等調整前四半期純利益	5,498	4,624
法人税、住民税及び事業税	1,074	927
法人税等調整額	661	14
法人税等合計	1,735	941
少数株主損益調整前四半期純利益	3,762	3,682
少数株主利益	92	68
四半期純利益	3,670	3,614

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	3,762	3,682
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,237	△798
為替換算調整勘定	△3,871	190
在外子会社の退職給付債務調整額	67	226
持分法適用会社に対する持分相当額	0	4
その他の包括利益合計	△5,040	△376
四半期包括利益	△1,277	3,305
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,319	3,231
少数株主に係る四半期包括利益	41	74

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	5,498	4,624
減価償却費	5,392	5,026
減損損失	419	122
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△574	△945
固定資産除売却損益 (△は益)	133	152
受取利息及び受取配当金	△351	△397
支払利息	171	159
投資有価証券評価損益 (△は益)	206	9
売上債権の増減額 (△は増加)	△3,884	△2,341
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,779	△3,002
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△493	△400
仕入債務の増減額 (△は減少)	3,197	1,772
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	691	118
その他	△599	△607
小計	8,029	4,291
利息及び配当金の受取額	358	399
利息の支払額	△235	△160
法人税等の支払額	△690	△767
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,462	3,763
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△4,580	△5,010
有形固定資産の売却による収入	228	69
投資有価証券の取得による支出	△6	△1,573
その他	△508	△588
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,867	△7,102
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△82	40
コマーシャル・ペーパーの増減額 (△は減少)	△3,000	△5,000
配当金の支払額	△1,204	△1,806
その他	△458	△468
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,745	△7,234
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,007	103
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△3,157	△10,469
現金及び現金同等物の期首残高	32,405	37,834
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,248	27,365

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報等

I 前第2四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連 結損益計 算書計上 額 (注) 3
	半導体 関連材料	回路製品	高機能 プラス チック	クオリテ ィオブラ イフ関連 製品	計				
売上高									
外部顧客への売上高	27,436	10,337	30,575	29,207	97,556	352	97,908	—	97,908
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	201	128	330	—	330	△330	—
計	27,436	10,337	30,777	29,336	97,887	352	98,239	△330	97,908
セグメント利益又は 損失(△)	3,983	△883	3,427	1,429	7,957	24	7,981	△1,748	6,233

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、試験研究の受託、土地の賃貸等を含んでおります。

2 「セグメント利益又は損失(△)」の調整額△1,748百万円には、セグメント間取引消去15百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,763百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究費用等であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連 結損益計 算書計上 額 (注) 3
	半導体 関連材料	回路製品	高機能 プラス チック	クオリテ ィオブラ イフ関連 製品	計				
売上高									
外部顧客への売上高	26,948	7,975	31,210	28,841	94,975	351	95,326	—	95,326
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	194	67	261	—	261	△261	—
計	26,948	7,975	31,404	28,909	95,237	351	95,588	△261	95,326
セグメント利益又は 損失(△)	2,068	△534	2,807	1,558	5,899	△24	5,874	△1,608	4,266

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、試験研究の受託、土地の賃貸等を含んでおります。

2 「セグメント利益又は損失(△)」の調整額△1,608百万円には、セグメント間取引消去5百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,614百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究費用等であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

各報告セグメントの主要な製品および役務の内容は以下のとおりであります。

報告セグメント	主要な製品および役務の内容
半導体関連材料	半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、感光性ウェハーコート用液状樹脂、半導体用液状樹脂、半導体実装用キャリアテープ、半導体チップ接着用テープ、半導体基板材料
回路製品	フレキシブル・プリント回路、フェノール樹脂銅張積層板、エポキシ樹脂銅張積層板
高機能プラスチック	フェノール樹脂成形材料、工業用フェノール樹脂、精密成形品、合成樹脂接着剤
クオリティオププライブ 関連製品	医療機器製品、メラミン樹脂化粧板・不燃板、ビニル樹脂シートおよび複合シート、鮮度保持フィルム、ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板、防水工事の設計ならびに施工請負、バイオ製品

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(7) 重要な後発事象

該当事項はありません。